



Wärmeleitpaste, in handlicher Spritze, 2 ml

- Ideal für den Einsatz auf Chips, vermeidet Lufträume zwischen CPU (Central processing unit= Prozessor) und Kühler
- Silikonfrei und geeignet für mittlere Temperaturen
- Hohe Wärmeleitfähigkeit garantiert schnelles Abführen der Wärme von CPU/GPU
- Metallfrei, eliminiert das Risiko von Kurzschlüssen und Entladungen
- Vermeidet Korrosionsschäden am Kühlerboden

Dichte bei 20°C: 2 g/cm³
 Wärmeleitfähigkeit: 0,7 W/mk
 Flammpunkt: +280 °C
 Schmelzpunkt: -40 °C
 Gebrauchstemperatur von bis: -40 °C bis +150 °C

Heat Conductive Paste, in Handy Squirts, 2 ml

- Ideal for use on chips, avoids air spaces between CPU (central processing unit) and cooler
- Silicone-free and suitable for medium temperatures
- High thermal conductivity guarantees fast heat dissipation from CPU/GPU.
- Completely metal-free, eliminates the risk of short circuits and discharges
- Avoids corrosion damage to the radiator bottom

- Density at 20°C: 2 g/cm³
 - Thermal conductivity: 0.7 W/mk
 - Flame point: +280 °C
 - Melting point: -40 °C
 - Operating temperature from to: -40 °C to +150 °C

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	16.05.2025	alw
		gepr.:	16.05.2025	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

WLPF 05 Wärmeleitpaste
 Spritze 2 ml

Zeichnungs-Nr.:

44839



Blatt

1/1

von